

Title (en)

Electrolyte for electrochemically polishing metal surfaces.

Title (de)

Elektrolyt zum elektrochemischen Polieren von Metalloberflächen.

Title (fr)

Electrolyte pour le polissage électrochimique de surfaces de métaux.

Publication

EP 0249650 A1 19871223 (DE)

Application

EP 86108474 A 19860620

Priority

EP 86108474 A 19860620

Abstract (en)

[origin: US4740280A] The electrolyte according to the invention for electrochemically polishing articles made of steel, stainless steel, nickel alloys, aluminum, and aluminum alloys, and containing phosphoric acid and sulfuric acid comprises an addition of a chelating agent on the basis of phosphonic acids and, if desired, a stabilizer for the latter.

Abstract (de)

Der erfindungsgemäße Elektrolyt zum elektrochemischen Polieren von Gegenständen aus Stahl, Edelstahl, Nickellegierungen, Aluminium und Aluminiumlegierungen, enthaltend Phosphorsäure und Schwefelsäure, weist einen Zusatz an einem Chelatbildner auf der Basis von Phosphonsäure auf sowie gegebenenfalls einen Stabilisator hierfür.

IPC 1-7

C25F 3/20; **C25F 3/22**; **C25F 3/24**

IPC 8 full level

C25F 3/16 (2006.01); **C25F 3/20** (2006.01); **C25F 3/22** (2006.01); **C25F 3/24** (2006.01)

CPC (source: EP US)

C25F 3/20 (2013.01 - EP US); **C25F 3/22** (2013.01 - EP US); **C25F 3/24** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] GB 1070644 A 19670601 - DIVERSEY U K LTD
- [A] US 2820750 A 19580121 - ALLAN CHARLESWORTH PERCY
- [A] DD 205198 A1 19831221 - MATSCHINER HERMANN, et al
- [A] CHEMICAL ABSTRACTS, Band 103, Nr. 6, 12. August 1985, Seite 697, Zusammenfassung Nr. 47409a, Columbus, Ohio, US; S. LUO et al.: "XPS study of the composition of viscous liquid film on the electropolished copper surface", & HUAXUE XUEBAO 1985, 43(3), 278-81

Cited by

DE10151180A8; DE10151180A1; DE10151180B4; WO2016030506A1; WO2005004941A1; WO2007017156A1; WO9220841A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0249650 A1 19871223; **EP 0249650 B1 19891213**; AT E48661 T1 19891215; DE 3667505 D1 19900118; JP S634100 A 19880109; US 4740280 A 19880426

DOCDB simple family (application)

EP 86108474 A 19860620; AT 86108474 T 19860620; DE 3667505 T 19860620; JP 15152587 A 19870619; US 6409587 A 19870618